

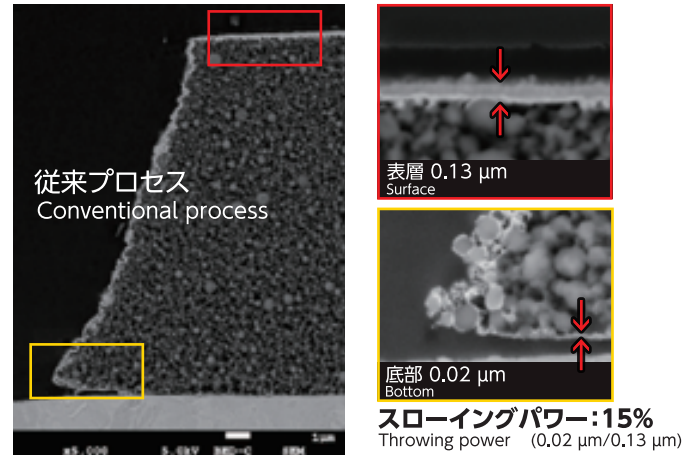
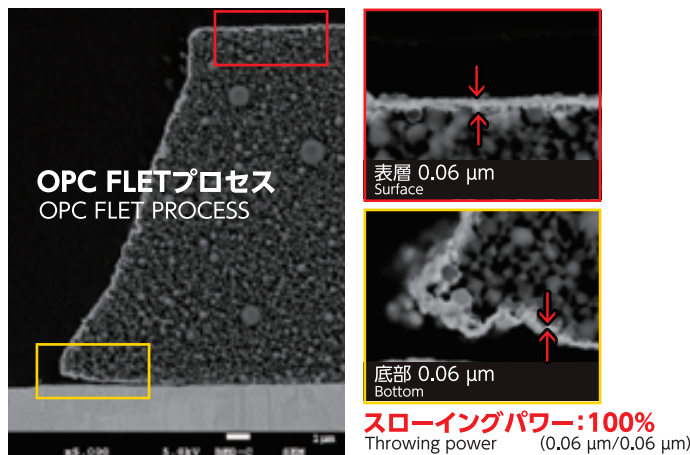
OPC FLETプロセス

OPC FLET PROCESS

- 低膜厚で高スローイングパワーの実現
Realize high throwing power by small thickness
- ビア底との優れた接続信頼性を達成
Excellent in connecting reliability at via-hole bottom
- 低粗度材料でも高いピール強度が得られる
High peel strength to low Ra material
- 均一な薄膜シード層を形成でき、回路形成性に優れる
Can form thin seed layer and ultra fine patterns

低膜厚でビアへのつきまわり性に優れる

High via-covering performance by small thickness

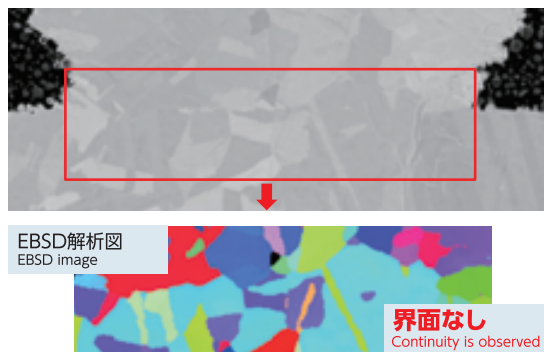


ビア底の結晶連続性が得られる

Excellent in crystal continuity at via bottom

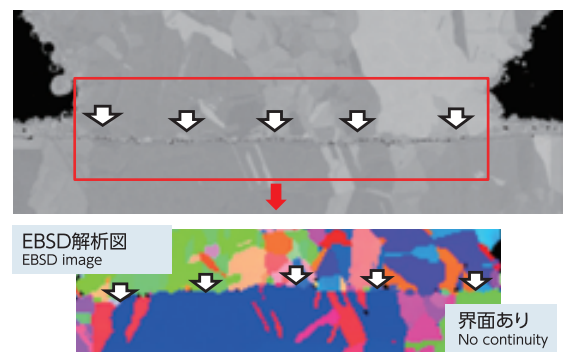
OPC FLETプロセス

OPC FLET PROCESS



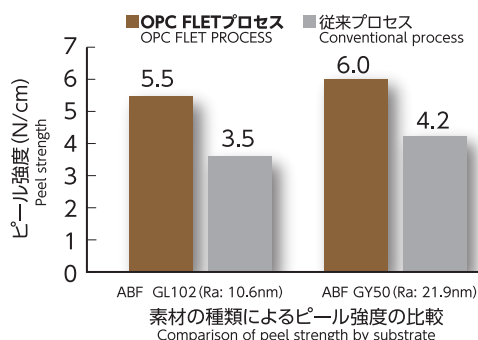
従来プロセス

Conventional process



低粗度材料でも高いピール強度

High peel strength to low Ra material



超微細回路形成

Ultra Fine Pattern Formation

シード層エッチング後
After flash etching

L/S=1/1 μm 達成
L/S=1/1 μm can be realized

